

【11】證書號數：I462685

【45】公告日：中華民國 103 (2014) 年 11 月 21 日

【51】Int. Cl.： H05K5/04 (2006.01)

發明

全 2 頁

【54】名稱：電子裝置殼體

HOUSING FOR ELECTRONIC DEVICE

【21】申請案號：099101418

【22】申請日：中華民國 99 (2010) 年 01 月 19 日

【11】公開編號：201127257

【43】公開日期：中華民國 100 (2011) 年 08 月 01 日

【72】發明人：姜傳華 (TW) CHIANG, CHWAN HWA；杜琪健 (CN) DU, QI-JIAN

【71】申請人：富士康 (香港) 有限公司 FIH (HONG KONG) LIMITED
香港

【74】代理人：虞彪

【56】參考文獻：

TW I225850

TW I284746

TW I317384

TW 200810587A

陳信璋碩士論文，“射出成型參數對光學鏡片表面粗糙度的影響”，國立高雄應用科技大學，2007 年 7 月

審查人員：林佳毅

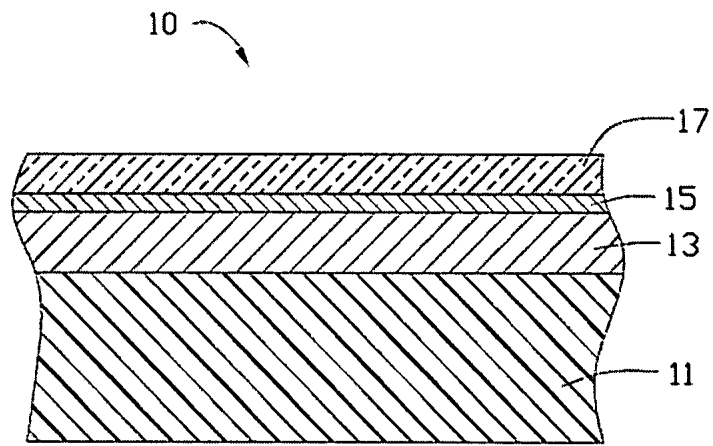
[57]申請專利範圍

1. 一種電子裝置殼體，其包括一基體及形成於基體表面的金屬氧化物膜，其改良在於：所述基體表面的粗糙度值在 60nm 以下，該金屬氧化物膜包括有具不同折射率的相互交替排列的氧化物層，該不同折射率的氧化物層選自為五氧化二鉍氧化物層與二氧化矽氧化物層的組合或五氧化二鉍氧化物層與氧化鋯氧化物層的組合，所述五氧化二鉍氧化物層為 3-4 層，二氧化矽氧化物層為 3-4 層，所述殼體的表面光澤度值為 100-200 光澤單位。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述的電子裝置殼體，其中所述基體由塑膠或陶瓷製成。
3. 如申請專利範圍第 1 項所述的電子裝置殼體，其中所述金屬氧化物膜的厚度為 10-1000nm。
4. 如申請專利範圍第 1 項所述的電子裝置殼體，其中所述金屬氧化物膜以真空濺鍍的方式形成。
5. 如申請專利範圍第 1 項所述的電子裝置殼體，其中所述五氧化二鉍氧化物層為 3-4 層，氧化鋯氧化物層為 3-4 層。
6. 如申請專利範圍第 1 項所述的電子裝置殼體，其中所述殼體還包括一形成於基體與金屬氧化物膜之間的底漆層。
7. 如申請專利範圍第 6 項所述的電子裝置殼體，其中所述底漆層為丙烯酸樹脂漆層，其厚度在 1-30 μ m 之間。
8. 如申請專利範圍第 1 項所述的電子裝置殼體，其中所述殼體還包括一形成於金屬氧化物膜表面的面漆層。
9. 如申請專利範圍第 8 項所述的電子裝置殼體，其中所述面漆層為紫外光固化漆層。

圖式簡單說明

圖 1 為本發明一較佳實施方式電子裝置殼體的剖視示意圖。

(2)



■ 1